

浙江拓感科技有限公司 2022 届校园招聘

【公司介绍】

浙江拓感科技有限公司是由杭州海康威视联合国家级人才计划特聘专家归国博士以及多位半导体芯片专家等共同发起,面向新一代化合物半导体芯片制造的高技术企业。

【招聘对象】

2022 届海内外高校本科、硕士、博士应届毕业生

【招聘岗位】

职位一 芯片研发工程师

需求人数: 6

职位 JD:

1. 负责激光器、探测器等器件芯片的研发
2. 负责根据项目要求进行半导体芯片的光刻/镀膜/刻蚀/清洗等工序的新工艺的开发与现有工艺的优化改进;
3. 编写相关工序工艺文件并对生产员工进行培训监督。

微电子学与固体电子学、凝聚态物理、半导体物理、电子科学与技术、材料、物理、光电材料与器件等相关专业;

职位二 芯片后道研发工程师

需求人数: 3

职位 JD:

1. 负责芯片后道工艺的研发;
2. 根据项目需求进行填胶、减薄、抛光等工艺的开发;
3. 编写相关工艺文件并对生产员工进行培训监督。

微电子学与固体电子学、凝聚态物理、半导体物理、电子科学与技术、材料、物理、光电材料与器件等相关专业;

职位三 芯片工艺整合工程师

需求人数: 2

职位 JD:

- 1.负责半导体芯片激光器以及探测器等产品的工艺流程研发和优化设计;
- 2.协调后工艺的开发与控制-光刻, 湿式蚀刻, 等离子体蚀刻, 金属和介电沉积

系统, 镀膜, 注入和氧化;

3.负责生产工艺异常分析处理和失效分析。改良优化工艺流程, 提升良率,质量管控;

4.负责编制技术文件规范和标准, 技术培训指导,制作作业指导书;

5.完成公司制定的项目研发计划。

微电子学与固体电子学、凝聚态物理、半导体物理、电子科学与技术、材料、物理、光电材料与器件等相关专业;

职位四 真空封装工程师

需求人数: 3

职位 JD:

1. 负责芯片的真空封装结构以及工艺的开发;

2. 根据项目需求开发焊接、粘接、键合、排气等工艺;

3. 芯片低温封装方案制定和开发, 封装的材料选型, 为芯片提供有竞争力的解决方案;

4. 利用 CAD 软件对真空金属杜瓦进行设计开发工作;

5、封装散热、应力、材料特性、可靠性等的设计、仿真分析与测试验证;

6、承担部分封装技术能力建设、流程建设、人才培养和项目交付职责。

材料、微电子、化学、机械设计及其自动化、材料加工与成型等相关专业。

职位五 测试工程师

需求人数: 2

职位 JD:

1. 负责芯片与组件性能测试工作, 参与产品需求分析, 负责测试计划制定, 预先评估项目风险, 确保测试活动的顺利开展;

2. 根据产品需求和产品设计, 编写功能测试设计和用例, 开发自动化测试脚本;

3. 实施软件测试, 完成对产品的集成测试和系统测试;

4. 保证被测系统的质量, 并通过测试流程和方法创新, 努力提升研发的质量和效率 requirements;

5. 撰写测试作业指导书并对生产员工进行培训, 督促生产员工按照作业指导书操作。

计算机、电子信息、软件工程、通信工程、机械电子工程、软件控制等相关专业

【薪酬福利】

- 1、具备行业内极具竞争力的薪酬，本科生薪资范围10-25万，研究生薪资范围15-30万，舒适的办公环境；
- 2、员工福利：五险一金、节日福利、食宿免费、政府人才补贴等；
- 3、完善的培训与职业发展体系，行业资深技术导师。

【招聘流程】

简历投递→简历筛选→面试→offer→签约入职

【联系我们】

公司地址：浙江嘉兴海宁市谷水路 306 号 A18

投递邮箱：kongping.wang@truesensor.com.cn

邮件请标明：姓名-学历-学校-专业-应聘岗位。